

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2026-012

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝箭电子	股票代码	301348
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张国光	林品旺	
办公地址	中国广东省佛山市禅城区古新路 45 号	中国广东省佛山市禅城区古新路 45 号	
传真	0757-63313400	0757-63313400	
电话	0757-63313388	0757-63313388	
电子信箱	zhangguoguang@fsbrec.com	linpinwang@fsbrec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所处细分行业及主要业务

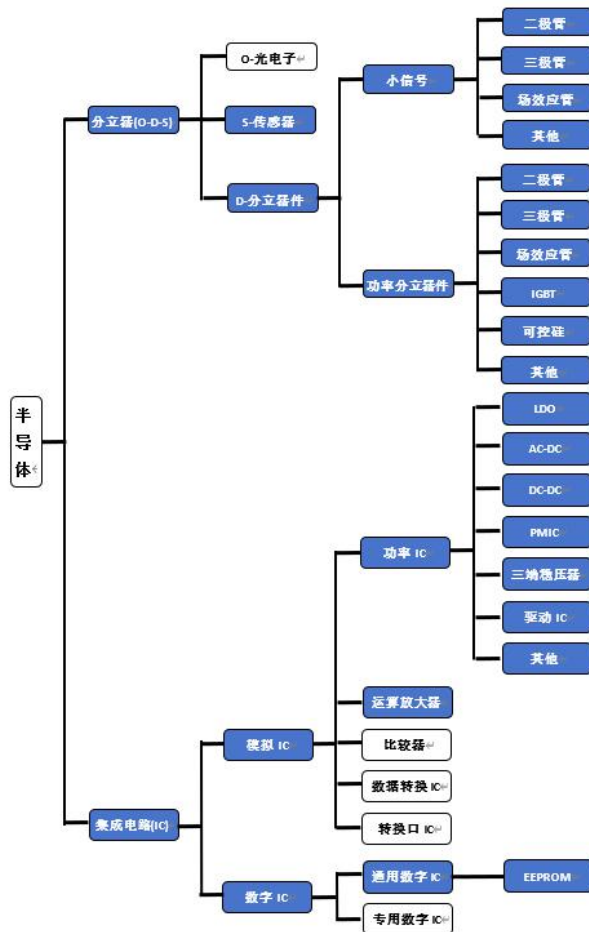
公司主要从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。

（二）公司主要产品及服务

公司是国内半导体器件专业研发制造商，依托强大的自主技术研发能力和丰富的客户资源，经过多年深入研发和市场拓展，已成为国内多家知名企业的供应商之一，同时公司也是华南地区半导体器件主要的生产基地之一。

公司主要从事半导体封装测试业务，是专业化的半导体封装测试厂商，在金属基板封装、全集成的锂电保护 IC、功率器件封装、超薄芯片封装、半导体/IC 测试、高可靠焊接、高密度框架封装、系统级封装（SIP）、倒装技术（FC）、Clip bond 封装等方面拥有核心技术。封装产品包括多个系列，主要包括 QFN、DFN/PDFN、SOT/TSOT、SOD、SOP/ESOP/HTSSOP、TO/TS、TOLL/TOLT 等。



同时，公司为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品，产品类型主要为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS 等分立器件产品和 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护充电管理 IC、LED 驱动 IC 及霍尔器件等集成电路产品。公司主营业务产品如下：















注：图中标蓝的产品为公司主营业务产品。

1. 分立器件产品

公司分立器件产品按照功率划分，包括：功率二极管、功率三极管、功率 MOS、IGBT 等功率器件和小信号二极管、小信号三极管等小信号器件产品；按照具体产品类别划分，公司分立器件产品包括开关二极管、稳压二极管、整流二极管（整流桥/堆）、肖特基二极管、快恢复二极管、ESD 保护二极管、瞬态抑制二极管、数字三极管、小信号三极管、功率三极管、平面型 MOSFET、沟槽型 MOSFET、屏蔽栅型 MOSFET、超结型 MOSFET 等产品；按照封装类型划分，公司分立器件产品主要封装形式包括 TO、SOT、SOD、SOP、DFN、PDFN、SMA、SMAF、SMB、SMBF、SMC、ABS、ABF、MBF、MBS、UMSB、DBS、KBJ、TOLL、TOLT、LPAK、D3K、GBL/P/U 等。








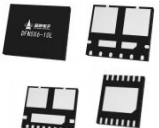
产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式			
分立器件	三极管	音频三极管	信号放大、信号开关、功率放大器等	消费类电子	电源、显示器、电话机、机顶盒等	封装产品规格齐全，功率器件采用创新结构设计。在产品设计上具有客户配套服务优势				
		普通三极管					TO-220F	TO-220	TO-252	TO-3P
		数字三极管								
		高反压三极管					DFN1006-3L	SOT-89	SOT-23	SOT-323/363
	二极管	肖特基二极管	电源整流、电流、流向、稳压、关等	消费类电子、网络通信、安防、汽车等	电源、家电、数码产品等	采用沟槽技术及铜桥封装工艺，产品具有优异的性能指标及电学参数				
		ESD/TVS					TO-252	TO-277	DFN1006-2L/DFN0603	DFN2510-10L
		稳压二极管								
		快恢复二极管					SOD-323	SOD-123FL	SMA/B/C	SMAF/SMBF
		整流桥、整流桥堆								
							MBF/S	ABF/S	D3K	GBL/P
										
							DB/DBS	KBJ	4GBJ	GBJ/U
	场效应管	平面型 MOSFET	信号放大、负载开关、功率控制	消费类电子、安防、网络通信、汽车	电源、充电器、电池保护、马达驱动、负载	采用有平面、沟槽和超结芯片工艺产品及铜桥封装工				
沟槽型 MOSFET		TO-252/251/247					TO-262/263	SOP-8	SOT23-3/6	











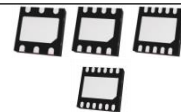

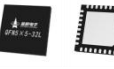

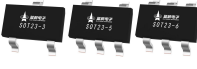




佛山市蓝箭电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式			
		屏蔽栅型 MOSFET	等	车 电子 等	开关等	艺，产品具有优异的性能参数				
		DFN/PDFN5×6/A					DFN2×2	DFN3×2-6L	PDFN3×3/3.3*3.3	
		超结型 MOSFET	等	车 电子 等	开关等	艺，产品具有优异的性能参数				
		DFN8×8/A-3/4L					PDFN8×8A-8L	LFPAK5×6	TOLL-8L	
IGBT	绝缘栅双极型晶体管	大功率放大输出功能	家用电器、汽车电子、智能电网等	逆变器、变频器、电机驱动、不间断电源	产品具有低栅极电荷、快速开关、低饱和压降等优势					
						TO-220F	TO-252	TO-247	TO-263	













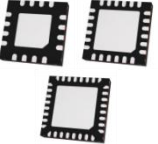


2. 集成电路产品

在集成电路领域，公司主要封装包括 TO、SOT/TSOT、SOP/ESOP/HTSSOP、DFN/PDFN、QFN 等系列，按照产品类别划分，主要产品包括 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护 IC、充电管理 IC 及 LED 驱动 IC 等。具体产品情况如下：

产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式			
集成电路	电源管理	LED 驱动 IC	通过交流转换成直流，为 LED 器件提供稳定可控的恒定电流，同时具备良好的抗干扰能力	广泛应用于照明电路、汽车电子等	日光灯、球泡灯、筒灯、射灯、面板灯、汽车转向灯、路灯等	采用自主设计框架，多芯片互连焊接技术，高密度焊线技术，多站点高效率 IC 的精准测试技术，高可靠性的封装技术				
							SOP-7/8/16	ESOP-8	TO-252	SOT89-3/5
										

产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式			
							SOT23-3/5/6	DFN1.6×1.6	DFN3×2	DFN5×6-10/12/14L
										
							DFN8×8/A-8L	DFN9×6-14L	QFN2×2-12/14L	QFN3×2-16L
		DC-DC	直流电压转换器，为线路提供稳定电压，起到噪声隔离、安全隔离等	广泛用于消费电子、汽车电子等	调制解调器、通信设备（平板电脑、数码相机等）	封装产品规格齐全，在粘片、压焊积累了深厚的技术沉淀，采用倒装技术，提供高功率密度、高可靠性的产品				
							SOP-8	SOT23-5/6	TSOT23-5/6	DFN1.2×1.2-6L
										
							DFN1.6×1.2-8L	DFN1.6×1.6/A-6L	DFN1.57×1.9-6L	DFN2×2-6/8/10L
										
							DFN3×2-8L	DFN3×3-6/8/10/12L	PDFN3×2-6L	QFN5×5-32L
										
		ESOP-8	SOT23-3/5/6	DFN1010-4L	DFN1.6×1.2A-8L					
										
DFN2×2-6/8L	DFN3×3/A/B/C/D-6/8/10L									

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式			
		充电管理 IC	安全、高效地控制电池的充电过程，并智能管理外部电源与电池之间的能量分配，为设备系统稳定供电	消费类电子	智能手机与平板电脑、TWS 耳机与智能穿戴、物联网与便携设备、智能小家电	高耐压、低功耗、充电电流精度高、充电电流智能热调节、具备电源过压保护和电池反接保护				
							SOT23-5/6	DFN2×2-6/8L	ESOP/SOP-8	DFN3x3/3x2
		稳压 IC	具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等	消费类电子、网络通信、安防等	数码产品、TV、家电、电脑等	具有负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等功能，低输出噪声、低静态电流及低压差				
							SOT-223	SOT23-3/5	SOT89-3L	TO-252
										
							DFN3×2-10L	DFN3×3-6L		
		AC-DC	交流转换成直流	消费类电子、安防、网络通信等	开关电源、充电器、适配器、电源控制板等	采用集成封装，内置高压功率开关器件，具备输出过压保护功能，欠压锁定保护功能，过温保护功能				
							SOP-7/8	QFN3×3-16/20L	QFN4×4-16/24/32L	HTSSOP16
		多通道阵列 TVS	为电子产品及通信系统提供防护静电及抗浪涌电流能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车电子等	高清多媒体接口、触摸屏等电子设备端口处，通信设备端口及基站等	通过新设计的高密度框架，降低成本提升效率，低电容、低钳位电压，为国内知名厂家配套服务				
							SOT23-6		SOP-8	

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

产品类别	产品名称	具体类别	主要功能	应用领域	具体应用	技术优势	封装形式	
		运算放大器	将输入端电压差进行高倍数放大，并通过外围电路，实现信号放大、数学运算、滤波、比较等多种模拟信号处理	消费类电子、安防、网络通信、工控、汽车电子等	功放音响、开关电源、充电桩、传感器、计算机设备、安防监控等	静态功耗低、失调电压小、宽输出摆幅、超低噪声		
							SOP-8	
		EEPROM	在断电后依然能长期保存数据，并支持通过电信号以“字节”为单位灵活地处理数据	消费类电子、安防、网络通信、工业控制、汽车电子等	智能门锁、打印机、智能表计、传感器、新能源、物联网设备等	超低功耗、宽工作电压范围、高可靠性		
							SOP-8	

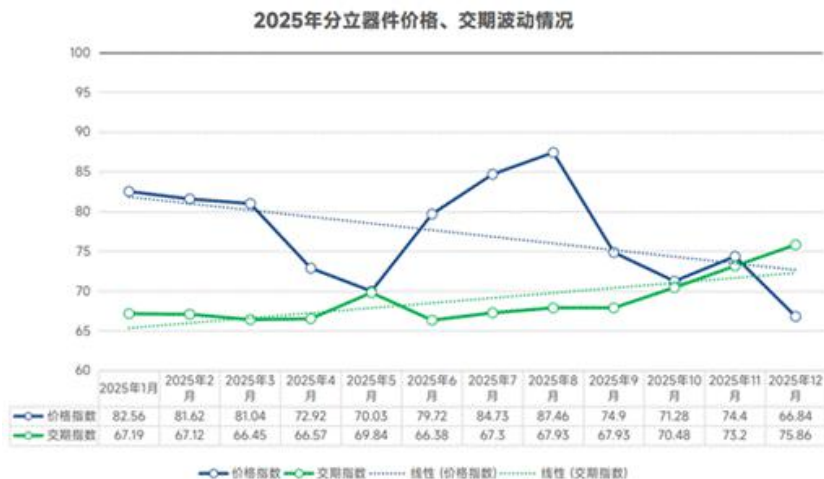
（三）细分行业发展和政策变化对公司的影响

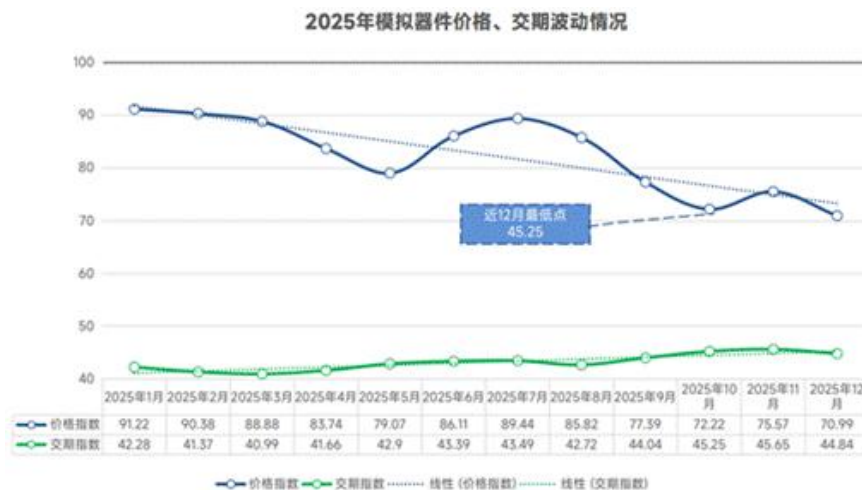
世界半导体贸易统计协会（WSTS）的相关数据显示，2025 年全球半导体市场同比增长 22%，市场规模达 7,720 亿美元，其中算力芯片、存储芯片成为驱动行业增长的核心动力。这一良好的行业发展态势，为国内半导体封装测试企业及上下游相关产业发展营造了有利的市场环境。而具体到与公司产品结构相关的细分领域，分立器件领域全球市场同比微降 0.4%；模拟电路领域受益于下游消费电子、工业控制、汽车电子等应用场景的持续复苏，全球市场同比增长 7.5%。

Autumn 2025	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Americas	195,123	251,926	338,574	45.2	29.1	34.4
Europe	51,250	54,127	60,429	-8.1	5.6	11.6
Japan	46,739	44,835	50,164	0.0	-4.1	11.9
Asia Pacific	337,437	421,354	526,293	16.4	24.9	24.9
Total World - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3
Discrete Semiconductors	31,026	30,900	33,436	-12.7	-0.4	8.2
Optoelectronics	41,095	42,597	45,020	-4.8	3.7	5.7
Sensors	18,923	20,894	22,713	-4.1	10.4	8.7
Integrated Circuits	539,505	677,852	874,291	25.9	25.6	29.0
Analog	79,588	85,552	91,988	-2.0	7.5	7.5
Micro	78,633	84,839	96,620	3.0	7.9	13.9
Logic	215,768	295,892	390,863	20.8	37.1	32.1
Memory	165,516	211,568	294,821	79.3	27.8	39.4
Total Products - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3

数据来源：WSTS

芯查查企业 SaaS《2025 年 12 月元器件供应链监测和风险预警报告》则从市场供需、价格波动等实操层面，进一步补充了行业发展细节：分立器件领域全年价格指数基本维持较低的水平运行，显示该细分领域存在价格承压明显、市场竞争激烈，且该品类供给相对充裕、下游需求恢复不足，价格主要依赖阶段性补库存或短期需求波动支撑；模拟电路方面，2025 年价格指数整体呈现震荡下行、反弹乏力的运行特征，反映出该板块价格承压明显、市场议价权偏向下游。尽管模拟电路领域整体受益于下游场景复苏，需求保持稳定，部分核心细分品类需求呈现正向表现，但价格端的承压态势仍较为突出。





数据来源：芯查查企业 SaaS (XCC.COM)

在产业政策的有力扶持与下游应用需求的持续带动下，国内封测市场伴随集成电路产业整体发展实现稳步扩容，市场规模从 2019 年的 2,349.8 亿元增长至 2024 年的 3,319.0 亿元，年均复合增长率达 7.2%。展望未来，随着全球集成电路产业重心逐步向中国国内转移，我国的封测行业有望保持长期增长态势，预计市场规模将在 2029 年达到 4,389.8 亿元，2024 年至 2029 年间复合增长率约为 5.8%。据 Yole Group 《Status of the Advanced Packaging Industry 2025》预测，2024 年全球先进封装市场规模约为 380 亿美元，预计将以 9.4% 的年复合增长率持续增长，到 2030 年达到约 790 亿美元。

在行业态势之外，当期国内相关政策对公司发展影响显著，2025 年集成电路行业政策也呈现明显变化，逐步形成“顶层设计引领、专项政策支持、地方配套落地”的完善支持体系。相较于以往，2025 年行业政策更聚焦半导体产业自主化、高端化发展目标，强化全链条支持力度，推动扶持政策从“普惠性”向“精准化”转变，助力国产替代进程加速推进。其中，两大核心政策文件发挥了关键引领作用：一是《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，作为顶层设计文件，将半导体纳入战略性新兴产业集群，明确提出完善新型举国体制，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关，为行业整体发展指明方向、提供战略支撑；二是中国人民银行、工信部等七部门联合印发的《关于金融支持新型工业化的指导意见》，聚焦金融赋能半导体等制造业重点产业链，发挥结构性货币政策工具激励作用，引导银行为集成电路领域技术攻关提供中长期融资支持，为突破关键核心技术的科技企业开通上市融资、并购重组、债券发行“绿色通道”，有效缓解行业在研发、产能优化过程中的资金压力。此外，广东结合区域产业布局，针对性对半导体公司在生产基地给予产能、技术方面的专项扶持，精准衔接国家政策导向与公司实际经营需求，为公司核心封装测试业务的稳步推进筑牢政策保障。

序号	时间	发布机构	文件名称	有关本行业的主要内容
1	2025 年	中共中央	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	“十五五”规划建议提出：完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
2	2025 年	中国人民银行、工信部等七部门联合印发	《关于金融支持新型工业化的指导意见》	发挥结构性货币政策工具激励作用，引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。
3	2025 年	广东省工业和信息化厅	《广东省工业和信息化厅经管省级财政专项资金管理办法（2024 年修订）的通知》	支持高端芯片、智能传感器关键核心产品研发及产业化，具体包括：采用 28nm 及以下制程流片的芯片；车规级芯片；AI 芯片（28nm 以上制程芯片的单核算力≥300GOPS）；采用 MEMS 工艺量产的智能传感器芯片；在广东省内芯片代工产线流片的芯片。
4	2025 年	市场监管总局、工业和信	《计量支撑产业新质生产力发展行动方案	重点突破扁平化量值传递技术，攻克晶圆级缺陷颗粒计量测试、集成电路参数标准芯片化等技术瓶颈。这些技术的突破将大幅提

		息化部联合印发	《(2025—2030 年)》	升集成电路制造的精度和良率，为国产芯片的竞争力提供关键支撑。
5	2024 年	国家发展改革委财政部	《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》	统筹安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
6	2024 年	工业和信息化部	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。

综合而言，上述各类因素对公司的影响呈现鲜明两极分化：积极方面，行业向好态势叠加国产替代进程推进，直接利好公司分立器件、模拟电路两大品类产品；2025 年行业政策优化及两大核心政策文件落地实施，公司在研发、产能优化过程中有望受益，进一步巩固公司的封测一体化优势，有效提升公司经营稳定性。潜在挑战方面，受行业客观环境、技术迭代节奏加快及原材料成本快速上涨等相关挑战影响，公司盈利空间仍面临挑战，后续需依托政策红利，聚焦业务结构优化与核心技术攻坚，积极适配行业发展变化，稳步应对经营过程中的各类阶段性问题。

(四) 公司所处行业竞争格局情况

2025 年中国半导体封测行业呈现“技术分层竞争、结构分化明显”的特征，先进封装与传统封装形成“高端垄断趋强、低端充分竞争”的二元结构。这一格局的形成，既源于技术壁垒的天然分割，也受下游需求结构与产能布局影响。

先进封装作为行业增长核心，技术壁垒高、利润空间相对较大，竞争呈现“头部聚集、有限竞争”特征。随着摩尔定律逼近极限，先进封装成为“超越摩尔”的主战场，2.5D/3D 集成、Chiplet、扇外型封装等技术成为竞争焦点，其对中段工艺、设备精度及协同设计能力要求极高，且需大额资本投入扩产。传统封装则处于充分竞争状态，产品同质化且利润空间较小。传统封装以引线键合工艺为主，技术成熟，核心竞争维度集中于产能规模与成本控制。目前国内传统封装产能充足，加工费持续下行，尾部出清速度加快，仅具备稳定客户资源或细分适配能力的企业可维持盈利，行业竞争充分且格局分散，定价策略已成为行业竞争的主要方式。

从整体竞争属性来看，行业二元结构显著，非完全充分竞争市场。先进封装领域因技术、资金、客户壁垒形成头部主导的有限竞争，传统封装领域呈现充分竞争特征。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因：上年同期基本每股收益和稀释每股收益因资本公积转增股本变动影响进行了重新计算。

元

	2025 年末	2024 年末		本年末比上年末增减 调整后	2023 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,983,414,44 3.38	1,874,396,63 5.95	1,874,396,635. 95	5.82%	1,917,266,563. 60	1,917,266,56 3.60
归属于上市公司股东的净资产	1,477,331,32 0.12	1,526,702,46 5.97	1,526,702,465. 97	-3.23%	1,567,590,701. 60	1,567,590,70 1.60
	2025 年	2024 年		本年比上年	2023 年	

				增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	711,979,750.47	713,059,932.31	713,059,932.31	-0.15%	736,580,879.68	736,580,879.68
归属于上市公司股东的净利润	-37,371,145.85	15,111,764.37	15,111,764.37	-347.30%	58,368,765.24	58,368,765.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,997,191.83	10,892,252.47	10,892,252.47	-448.85%	42,395,530.89	42,395,530.89
经营活动产生的现金流量净额	158,962,745.22	139,038,717.12	139,038,717.12	14.33%	92,607,221.44	92,607,221.44
基本每股收益(元/股)	-0.16	0.08	0.06	-366.67%	0.35	0.2900
稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.08	0.06	-366.67%	0.35	0.2900
加权平均净资产收益率	-2.49%	0.98%	0.98%	-3.47%	5.75%	5.75%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	138,884,950.41	199,836,396.80	179,208,189.40	194,050,213.86
归属于上市公司股东的净利润	-7,289,929.43	-3,709,242.29	-15,501,503.16	-10,870,470.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,424,759.06	-3,765,935.65	-15,904,212.23	-10,902,284.89
经营活动产生的现金流量净额	65,398,002.95	40,615,327.11	38,198,842.97	14,750,572.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,708	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				

					股份状态	数量
王成名	境内自然人	15.83%	38,003,316.00	38,003,316.00	不适用	0.00
陈湛伦	境内自然人	9.86%	23,659,462.00	23,659,462.00	不适用	0.00
张顺	境内自然人	7.55%	18,129,078.00	18,129,078.00	不适用	0.00
上海银圣宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.76%	16,223,445.00	0.00	不适用	0.00
舒程	境内自然人	1.77%	4,254,623.00	0.00	不适用	0.00
曾周洁	境内自然人	0.82%	1,972,620.00	0.00	不适用	0.00
赵秀珍	境内自然人	0.81%	1,952,694.00	1,762,694.00	不适用	0.00
袁凤江	境内自然人	0.78%	1,866,778.00	1,400,084.00	不适用	0.00
张国光	境内自然人	0.46%	1,096,142.00	930,032.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	1,091,699.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			王成名、陈湛伦、张顺为一致行动人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

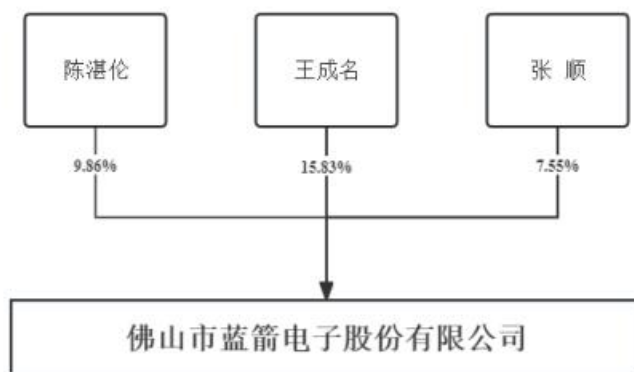
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 权益分派顺利完成

公司于 2025 年 7 月 4 日完成 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）并转增 2 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-025）。

（二）对外投资

1. 为了进一步深化与公司客户的长期战略合作关系，形成产业协同效益，公司于 2025 年 7 月完成对派德芯能半导体（上海）有限公司的战略增资入股，该事项已完成工商注册登记手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和本公司《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东会审批。

2. 2025 年 9 月，基于长远可持续发展的战略规划，公司已完成以自有资金人民币 2,000 万元认缴深圳芯展速科技发展有限公司（以下简称“芯展速”）新增注册资本出资额人民币 333,333.33 元；该事项已完成工商注册登记手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和本公司《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东会审批。本次对外投资参股芯展速，是结合了芯展速在半导体高性能企业级存储主控芯片、模组、数据服务领域的优势和公司在封装测试领域的技术与制造能力，实现资源协同、技术赋能，全力推进半导体存储领域的技术创新和业务拓展，提升公司核心竞争力。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资参股公司的公告》（公告编号：2025-036）。

3. 基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，公司与洪锋明、洪锋军等签署《股权收购意向协议》，以支付现金的方式收购成都芯翼科技有限公司不低于 51%的股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。本次签署的《股权收购意向协议》为意向性协议，本次《股权收购意向协议》的签署不构成上市公司的关联交易或其他利益安排，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体详见公司于 2026 年 1 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2026-001）。